

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 新型片式电子元器件上下封带

请输入查询关键词

科技频道

搜索

## 新型片式电子元器件上下封带

关键词: **电子元器件** **片式** **封带**

所属年份: 2005

成果类型: 应用技术

所处阶段: 成熟应用阶段

成果体现形式: 新材料

知识产权形式: 发明专利

项目合作方式: 其他

成果完成单位: 荆门市维益电子包装材料有限公司

成果摘要:

新型片式电子元器件上下封带采用多层涂布、复合延压技术,用热熔胶将基带(聚酯薄膜、精大通带纸)粘合成多层,然后通过熟化和防静电处理而成,项目所采用的技术路线是在国外先进生产实践的基础上,研究成形的。因此,所采用的技术具有相当的工业化生产的可行性,片式电子元器件上、下封带生产工艺,已获国家发明专利两项,具有独立的自主知识产权,大部分原料和生产测试设备可在国内市场获得。

成果完成人: 王洪柱;李明;王兵;胡先成;何秀兰

[完整信息](#)

### 行业资讯

- 管道环氧粉末静电喷涂内涂层...
- 加氢处理新工艺生产抗析气变...
- 超级电容器电极用多孔炭材料...
- 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的...
- 库尔勒香梨排管式冷库节能技...
- 高温蒸汽管线反射膜保温技术...
- 应用SuperIV型塔盘、压缩机注...
- 非临氢重整异构化催化剂在清...
- 利用含钴尾渣生产电积钴新工艺
- 引进PTA生产线机械密封系统的...

### 成果交流

### 推荐成果

- [新型稀土功能材料](#) 04-23
- [低温风洞](#) 04-23
- [大型构件机器缝合复合材料的研制](#) 04-23
- [异型三维编织增减纱理论研究](#) 04-23
- [飞机炭刹车盘粘结修复技术研究](#) 04-23
- [直升飞机起动用高能量密封免...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场预应力混凝...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场30000立方米...](#) 04-23
- [高性能高分子多层复合材料](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号